



行业动态  
Industry News

### 台湾日月光重庆芯片项目总投资额增至200亿元

2008-07-03 | 编辑: | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】

我国台湾地区芯片企业日月光集团,在重庆的芯片生产项目总投资可能由原来的10亿美元(约合70亿元人民币)增加至200亿元人民币。

“环旭电子(上海)有限公司是重庆市政府重点引进外资企业之一,初步计划投资200亿元在我市西永微电子工业园区建立分厂,建厂后每年都将需求大量高质量人才。”重庆邮电大学网站近日发布的《加强校企合作,搭建双赢平台》一文称,5月6日该校与环旭电子(上海)有限公司召开了关于校企人才培养与输送的座谈会,日月光集团旗下环旭电子(上海)有限公司供应链管理总处处长邱宗义、人力资源暨行政部经理刘士毅及厂务处处长刘明昭均参加此次会议。

此前,重庆市经委等部门的吸引投资的任务分解表中,计划吸引日月光集团在渝投资的芯片项目的总投资为80亿元人民币。主持本次座谈会的重庆邮电大学学生处伍安春处长6月24日对《第一财经日报》称,当时与会的重庆市信息产业局综合规划处副处长张建聪在这一会议上披露了日月光在重庆投资的总额为200亿元这一信息。

重庆市西永微电子产业园区建设委员会办公室副主任喻兰鹰6月23日称,该项目正在洽谈中,目前尚未得到有关该项目总投资变化的信息。但她向本报记者询问了消息来源。

重庆市信息产业局副局长、新闻发言人罗德6月24日在被问及日月光集团提升在渝投资总额及涉及具体哪些新增投资项目时表示:“现在还不方便发布这一数据,待正式签约时会发布相应信息。”

环旭电子(上海)有限公司负责信息发布的物料处黄天一处长日前返台,因此无法确认投资是否增加及是否增设芯片生产线等信息。

环旭电子(上海)有限公司目前在上海、昆山均设有工厂。重庆西永微电子产业园区官方网站的一则题为《日月光集团环旭电子(上海)有限公司考察园区》的文章称:“4月27日~30日,环旭电子(上海)有限公司陈逢达总经理等考察西永微电子产业园区。与园区就拟在园区投资建设日月光重庆产业园项目进行会谈。经双方初期相互对接及此次有针对性的考察项目落户所需条件,日月光集团意向在西永园区投资约1.5亿美元,建设日月光集团重庆产业园项目,规划占地面积约800亩,项目包括:资讯、通讯、消费电子及汽车电子等高端电子产品制作服务及研发中心项目;基板材料项目;半导体封装及测试项目。项目一期启动后预计2010年6月正式投产,五年内实现总产值10亿美元,实现就业人数约1万

▣ 科普首页

▣ 微电子历史

▣ 行业动态

▣ 术语解释

▣ 无微不至

▣ 芯片制程

▣ 科普创意



人。”

目前，重庆市已拥有2个芯片生产项目，分别是我国台湾茂德投资的8英寸数字芯片项目和中国电子科技集团的两条6英寸模拟芯片生产线项目。

本月初茂德重庆工厂试产成功，中国电子科技集团的6英寸芯片项目于今年6月18日动工。

日月光集团目前在重庆市核心商业区“解放碑”旁的校场口片区有一个地产项目，该项目总投资30亿元人民币，由6幢高度均超过200米的超高楼群组成，该项目还包含有28万平方米写字楼、13万平方米购物中心等物业。目前项目部分楼层已建设至120米左右。

来源：第一财经日报

2008年6月25日



中国科学院微电子研究所版权所有 邮编：100029

单位地址：北京市朝阳区北土城西路3号，电子邮件：webadmin@ime.ac.cn

京公网安备110402500036号